

構造接着・精密接着研究会

第 35 回構造接着・精密接着シンポジウム

「非破壊検査の最前線・産業応用～何が見えて何が見えないの？～」

一般社団法人日本接着学会 構造接着・精密接着研究会

本年度は、「非破壊検査の最前線・産業応用～何が見えて何が見えないの？～」と題して非破壊評価を先導する先生方に複合材料、接着接合に関するご講演を行っていただきたく考えております。ご講演だけでなく、装置デモンストレーションや登壇講師によるパネルディスカッションの時間も設けており、各分野での非破壊評価の課題とその解決策、どのような非破壊評価手法があればうれしい等の提案や期待について活発な議論をしていただきたく考えております。接着はつなげる／つながる学問・技術であり、様々な産業分野で活用され、かつ異分野でのつながり（情報交換）が期待できます。開催場所も多くの方が参加できる大きな場所を準備しております。ぜひ1年に1回のシンポジウムですので、多くの方に対面参加いただき、様々な分野の方とつながる（名刺交換／情報交換できる）ことを期待しております。

■開催日時：2026年11月13日（金）10:00～16:50（予定）

■開催形式：会場開催のみ（ハイブリッド等の対応は行いませんので、皆様、会場にお越しください）

■会場：大阪公立大学 I-site なんば（大阪・なんば）

<https://www.omu.ac.jp/isite/access/>

■プログラム（予定）：

10:00～10:05 開会挨拶

10:05～11:05 講演1：「次世代ものづくりを支える島津最新 X 線 CT システムの革新と実践」
株式会社島津製作所 小谷和範 氏

11:05～12:05 講演2：「AE 計測の基礎及び解析と適用事例」
株式会社 IHI 検査計測 中村 英之/木村 将人（デモ担当） 氏

12:05～13:05 昼休み

13:05～13:50 装置デモンストレーション（島津製作所/IHI 検査計測）

13:50～14:00 休憩

14:00～15:00 講演3：「調整中」
福井大学 松田 直樹 氏

15:00～16:00 講演4：「複合材料構造のライフサイクル・モニタリング
—検査・計測・AI がつなぐ設計から転用まで—」
東京科学大学 水谷 義弘 氏

16:00～16:10 休憩

16:10～16:45 登壇講師によるパネルディスカッション

16:45～16:50 閉会挨拶

17:30～19:30 技術交流会/名刺交換会

※シンポジウム終了後、同会場にて 17:30 から技術交流会（会費：2,200 円）を開催いたします。
多数のご出席をお待ちしております。

※プログラムは変更することがあります。構造接着・精密接着研究会 Web サイト
(<https://www.struct-adhesion.org/symposium/>) で最新情報をご確認ください。

■参加費（消費税別）：

構造接着・精密接着研究会 企業・団体会員：1人無料、2人目から10,000円/人

構造接着・精密接着研究会 個人会員：無料

日本接着学会会員（構造接着・精密接着研究会非会員）：20,000円

日本接着学会学生会員（構造接着・精密接着研究会非会員）：無料

構造接着・精密接着研究会、日本接着学会、共に非会員：25,000円

※日本接着学会の優待券は使用できません。

■参加申込方法：上記構造接着・精密接着研究会 Web サイトからお申し込みください。
右の2次元コードからアクセスできます。

■申込締切日：11月2日（月）10時

■問い合わせ先：一般社団法人日本接着学会 構造接着・精密接着研究会 事務局
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1065-7-106

TEL：045-414-2072 FAX：045-972-8887 E-mail：jimu@struct-adhesion.sakura.ne.jp

